

# ALS-HST热封盖带

## 产品介绍

ALS-HST盖带是指在一种应用于电子包装领域的带状产品，与载带配合使用，经过加温加压的情况下封合在载带的表面，形成闭合的空间，保护载带口袋中电子元器件。

## 性能参数

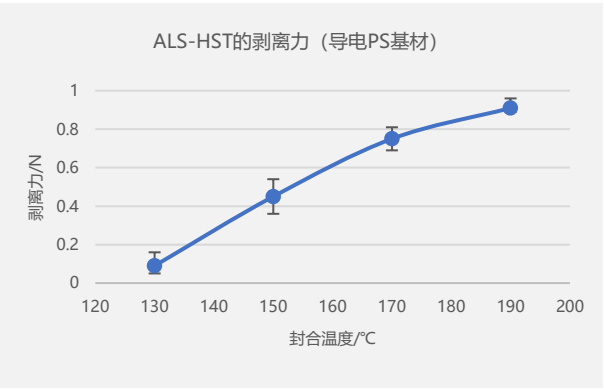
| 项目        | 测试标准                        | ALS-HST          | 单位    |
|-----------|-----------------------------|------------------|-------|
| 厚度        | /                           | 0.053            | mm    |
| 雾度        | JIS K-7105, Method A        | 30               | %     |
| 全光线透过率    | JIS K-7105, Method A        | 90               | %     |
| 拉伸强度      | JIS K-7127, No.4 test piece | 60               | MPa   |
| 表面电阻-PET面 | JIS K-6911                  | 10 <sup>10</sup> | Ω/sq. |
| 表面电阻-封合面  | JIS K-6911                  | 10 <sup>10</sup> | Ω/sq. |

## 封合温度和剥离力

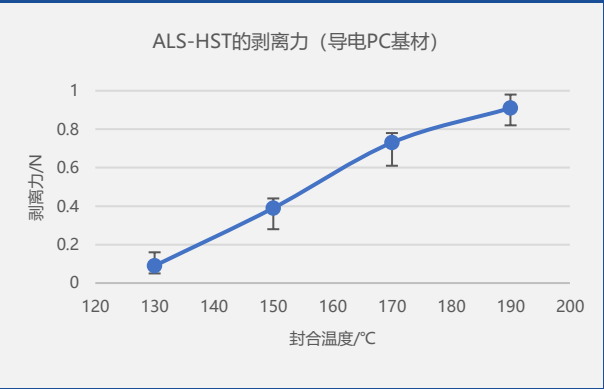
- ✓ 载带袋口尺寸不同，封合参数将有变化。
- ✓ 客户可以根据自己产品的特性制定标准。



## 封合特性-PS基材



## 封合性能-PC基材



## 特别提醒

- ✓ 剥离力不能满足贵司要求时，可以调整温度、压力和走带速度。
- ✓ 以上参数为我司测试值，仅供参考。

## 储存条件

- ✓ 温度及湿度：保管及使用场所湿浊环境必须控制在30°C/70%RH以下
- ✓ 必须避免日光的直射
- ✓ 必须防止挤、震动、不能在油污易贴附场所存放、使用